

300X300Mm加熱プラテンおよびプログラマブルPid制御を備えたヘビーデューティー40トン分割型自動ホットプレス

商品番号: XP39



前書き

300x300mmプラテン、独立したデュアルPID温度制御、多段プレスサイクル、40トン油圧圧力を備えたヘビーデューティー40トン分割型自動ホットプレス。実験室でのプレス、粉末冶金、電池研究、セラミック焼結に対応し、CE認証取得済み。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主なメリット
高度なセラミックホットプレス焼結	アルミナ、ジルコニア、窒化ケイ素、炭化ホウ素粉末を高性能コンポーネントに高密度化します。均一な温度場が、密度差や結晶成長を防ぎます。	均質な微細構造と最小限の内部応力を持つ、理論密度に近い密度が得られます。
粉末冶金圧縮成形	鉄、ステンレス鋼、タンガステンカーバイド、チタン合金粉末を、高いグリーン強度を持つグリーンピレットに予備焼結圧縮します。	グリーン密度を最大化し、焼結時の収縮を減らして、より厳しい寸法公差を可能にします。
全固体電池電極積層	固体電解質シートと複合電極をホットプレスし、多層セルにおける界面抵抗を最小限に抑え、剥離を防ぎます。	高いイオン伝導率と長いサイクル寿命を持つ、高品質で欠陥のない界面を作成します。
高性能ポリマー成形およびフィルム積層	燃料電池コンポーネントまたはフレキシブル電子機器用のPTFE、PEEK、PVDFおよび多層フィルムの圧縮成形と積層。	ボイドを排除し、寸法安定性と一貫した層間接着を保証します。
複合材料の一体化	航空宇宙パネルや自動車部品用の繊維強化熱可塑性または熱硬化性プリプレグのホットプレス。プログラム可能な圧力プロファイルが、繊維の洗い流れや積層物のボイドを防ぎます。	予測可能な機械的特性を持つ、低気孔率で高強度の積層板を製造します。
電子パッケージングおよび封止	精密な温度と圧力下で、封止フィルムをプリント基板または半導体基板に積層します。	優れた接着力でボイドのない封止を実現し、デバイスの信頼性を向上させます。
金属基複合材料 (MMC) 加工	セラミック粒子または繊維で強化された、アルミニウム、銅、またはマグネシウム基複合材料のホット圧縮。	重量重視のアプリケーションにおいて、均質性と機械的特性を向上させます。
タイヤおよびゴム試験片の調製	機械的特性評価のための試験シートまたは小型成形品へのゴム化合物の圧縮加硫。	ASTMおよびISO試験基準を満たす、一貫した欠陥のないサンプルを製造します。

仕様	値
モデル	XP39
タイプ	分割型自動ホットプレス
圧力範囲	0 - 40トン
プラテンサイズ	300 × 300 mm
最高使用温度	0 - 300 °C
加熱電力	4,800 W (2 × 2,400 W)

仕様	値
温度制御	PIDインテリジェントプログラマブル、独立デュアルチャンネル
圧力制御	PID自動プログラムホールド/定圧、タイマー付き自動リリース付き多段
ピストンストローク	50 mm
最大デライト開口	150 mm
冷却方式	循環水冷（外部チラーオプション）；クイックコネクタカップリング付属
制御インターフェース	7インチ高解像度産業用タッチスクリーン
電源	AC 220V / 50Hz、単相（最大21.8A、気流遮断器が必要）
寸法（概算）	800 × 440 × 620 mm（要確認）
正味重量（概算）	420 kg（要確認）
認証	CE